

## 請 求 の 範 囲

1. 一面にアンテナコイルを一体に形成した IC チップをコアピース本体の凹部内に装着して構成したコアピースと、

- 5 中央部に設けた嵌合部に前記コアピースを嵌合してコアピースを保持する非金属製のスペーサ部材と、

そのスペーサ部材の外周を取り囲むように配置・連結された金属製の重量付与部材とを備え、

- 10 前記アンテナコイルと金属製重量付与部材が前記スペーサ部材を介して離間していることを特徴とする非接触通信式情報担体。

2. 請求の範囲第 1 項記載の非接触通信式情報担体において、前記スペーサ部材の嵌合部が有底状の凹部あるいは貫通した透孔からなり、その嵌合部内にコアピース本体が強嵌合されていることを特徴とする非接触通信式情報担体。

- 15 3. 請求の範囲第 2 項記載の非接触通信式情報担体において、前記コアピース本体の外周面に環状凸部または環状溝部が設けられ、前記スペーサ部材の嵌合部の内周面に環状溝部または環状凸部が設けられて、その環状凸部と環状溝部が嵌合することを特徴とする非接触通信式情報担体。

- 20 4. 請求の範囲第 1 項記載の非接触通信式情報担体において、前記スペーサ部材の嵌合部が有底状の凹部からなり、その嵌合部の内周面またはコアピース本体の外周面に空気抜き溝が形成されていることを特徴とする非接触通信式情報担体。

- 25 5. 請求の範囲第 1 項記載の非接触通信式情報担体において、前記重量付与部材の中央部に透孔が形成され、その透孔内に合成樹脂製のス

ペーサ部材が強嵌合されていることを特徴とする非接触通信式情報担体。

6. 請求の範囲第5項記載の非接触通信式情報担体において、前記透孔の内周面に係止リブが形成され、その透孔内にスペーサ部材を強嵌合することにより、前記係止リブをスペーサ部材の外周部に食い込ませたことを特徴とする非接触通信式情報担体。

7. 請求の範囲第1項記載の非接触通信式情報担体において、前記重量付与部材の中央部に透孔が形成され、その透孔内に合成樹脂製のスペーサ部材がインサートモールドされていることを特徴とする非接触通信式情報担体。

8. 請求の範囲第7項記載の非接触通信式情報担体において、前記透孔の内周面に係止リブが形成され、その透孔内にスペーサ部材をインサートモールドすることにより、前記係止リブをスペーサ部材の外周部に食い込ませたことを特徴とする非接触通信式情報担体。

9. (補正後) 一面に非接触通信用のアンテナコイルを形成したICチップと、

前記ICチップを内装する非金属製の樹脂部材と、

- 前記樹脂部材を取り囲むように配置・連結された金属と合成樹脂の組成物からなる重量付与部材から構成されていることを特徴とする非接触通信式情報担体。

10. (削除)

11. 請求の範囲第9項記載の非接触通信式情報担体において、その非接触通信式情報担体がコイン形状を有し、その非接触通信式情報担体の中心位置に前記ICチップが内装されていることを特徴とする非接触通信式情報担体。

1 2. 一面にアンテナコイルを一体に形成した I C チップをコアピース本体の凹部内に装着して構成したコアピースと、

中央部に設けた嵌合部に前記コアピースを嵌合してコアピースを保持する金属を含まない合成樹脂からなるスペーサ部材と、

5 そのスペーサ部材の外周を取り囲むように配置されて金属と合成樹脂の組成物からなる重量付与部材を備え、

前記スペーサ部材と重量付与部材は 2 色成形されており、前記アンテナコイルと重量付与部材が前記スペーサ部材を介して離間していることを特徴とする非接触通信式情報担体。

10 1 3. 請求の範囲第 1 2 項記載の非接触通信式情報担体において、前記スペーサ部材の嵌合部が有底状の凹部あるいは貫通した透孔からなり、その嵌合部内にコアピース本体が強嵌合されていることを特徴とする非接触通信式情報担体。

1 4. 請求の範囲第 1 3 項記載の非接触通信式情報担体において、  
15 前記コアピース本体の外周面に環状凸部または環状溝部が設けられ、前記スペーサ部材の嵌合部の内周面に環状溝部または環状凸部が設けられて、その環状凸部と環状溝部が嵌合することを特徴とする非接触通信式情報担体。

1 5. 請求の範囲第 1 2 項記載の非接触通信式情報担体において、  
20 前記スペーサ部材の嵌合部が有底状の凹部からなり、その嵌合部の内周面またはコアピース本体の外周面に空気抜き溝が形成されていることを特徴とする非接触通信式情報担体。